

## Medienmitteilung für Fachpresse

Schaffhausen (Schweiz)

2. Juni 2026

### GF erhält „OCP Inspired™“-Siegel für branchenweit ersten In-Rack-Verteiler aus PVDF

**Der auf PVDF basierende In-Rack-Verteiler von GF für Direct-to-Chip Liquid Cooling (DLC) wurde mit dem OCP Inspired™-Siegel ausgezeichnet. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für den Einsatz fortschrittlicher Polymertechnologien in der Kühlinfrastruktur von Rechenzentren der nächsten Generation dar. Es ist der erste Verteiler auf Polymerbasis, der im Rahmen des Open Compute Project (OCP) Inspired™-Programms ausgezeichnet wurde.**

Als Teil des OCP-Ökosystems liefert GF Rohrleitungssysteme und Lösungen für Kühlmittelinfrastruktur aus Kunststoff, die speziell für Direct-to-Chip Liquid Cooling (DLC) in Hyperscale- und KI-Rechenzentren entwickelt wurden. Das LiquidCore-Portfolio von GF vereint Rohrleitungen, Ventile, Messtechnik, technisches Know-how, Verbindungstechnologien und Vorfertigung, und unterstützt damit eine zuverlässige und effiziente Kühlmittelverteilung vom gebäudeseitigen Kühlwasserkreislauf über das Technologiekühlsystem bis hin zum Chip über die Cold Plate.

Der In-Rack-Verteiler mit neuem OCP Inspired™-Siegel basiert auf der seit langem bewährten Materialplattform SYGEF PVDF von GF und wurde für anspruchsvolle Thermomanagement-Anwendungen entwickelt, wo Kühlmittelreinheit, Korrosionsbeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit entscheidend sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verteilern aus Metall verfügt er über ein Polymerdesign, das auf eine gleichmässige Strömungsverteilung über alle Auslassanschlüsse ausgelegt ist und so dazu beiträgt, eine stabile und wiederholbare Kühlleistung im gesamten Rack aufrechtzuerhalten. Die leichte PVDF-Konstruktion ermöglicht zudem einen korrosionsfreien Betrieb und eine vereinfachte Integration durch flexible Verbindungs- und Befestigungsmöglichkeiten.

Jeder Verteiler wird individuell nach den spezifischen Kundenanforderungen an Rack und Kühlung konstruiert und vor der Auslieferung einer 100-prozentigen Druckprüfung mit Wasser unterzogen, um maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit sicherzustellen. Das Verteilerkonzept hat sich bereits in zahlreichen Proof-of-Concept-Projekten und Installationen in realen Rechenzentren in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bewährt.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung mit unternehmenskritischen Anwendungen und Reinstwassersystemen für die Halbleiterfertigung treibt GF den Einsatz von Hochleistungskunststoffen in der Rechenzentrumkühlung der nächsten Generation voran. Das Unternehmen unterstützt seit langem führende Chiphersteller und Hightech-Branchen weltweit mit zuverlässigen Flow Solutions, die für äusserst anspruchsvolle Betriebsumgebungen ausgelegt sind.

„OCP spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Zusammenarbeit und Standardisierung in der gesamten Rechenzentrumsbranche“, sagte Charles Freda, Global Head Data Centers bei GF. „Die Auszeichnung mit dem OCP Inspired™-Siegel für unseren In-Rack-Verteiler aus PVDF spiegelt sowohl die Reife fortschrittlicher Polymer-Durchflusslösungen wider als auch unser Engagement für offene und interoperable Liquid-Cooling-Ökosysteme für Hochleistungsrechner.“

Direct Liquid Cooling, oder direkte Flüssigkeitskühlung, entwickelt sich rasch zum bevorzugten Kühlkonzept für KI- und Hochleistungs-Rechenumgebungen, in denen die Leistungsdichte der Racks immer häufiger 100 kW übersteigt. In diesen Systemen ist die Qualität und Zuverlässigkeit der Kühlmittelinfrastruktur entscheidend für die Aufrechterhaltung der thermischen Leistung und den Schutz empfindlicher Cold-Plate-Technologien. Die Kunststoffrohrleitungssysteme von GF wurden speziell entwickelt, um diesen Anforderungen durch korrosionsfreien Betrieb, glatte Innenoberflächen und Verbindungstechnologien mit minimierter Kontamination gerecht zu werden.

Mit standardisierten Schnittstellen und validierten Materialkonzepten fördert das OCP-Ökosystem zunehmend interoperable und herstellerübergreifende Infrastrukturen für Direct Liquid Cooling. Aktuelle Branchenrichtlinien für Liquid-Cooling-Systeme erkennen mehrere fortschrittliche Polymere als geeignete medienführende Werkstoffe an und fördern damit ihren Einsatz in Kühlanwendungen für Rechenzentren der nächsten Generation.

**Erfahren Sie mehr über die Polymerlösungen von GF für Direct-to-Chip Liquid Cooling:**  
[gfps.com/liquidcore](https://gfps.com/liquidcore)

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte**

Franciska Janzon  
Head Corporate Reporting and Media Relations  
Global Communications  
Phone +358401921653  
[franciska.janzon@georgfischer.com](mailto:franciska.janzon@georgfischer.com)

**Unternehmensprofil**

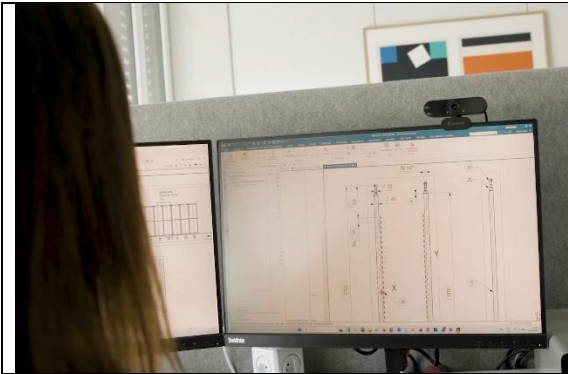
Mit einer reichen Tradition industrieller Innovation seit 1802 gestaltet GF die Zukunft von Flow Solutions und liefert Excellence in Flow durch geschäftskritische Produkte und Lösungen, die den sicheren und nachhaltigen Transport von Wasser und anderen Fluiden für Gebäude, Industrie und Infrastruktur ermöglichen. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt GF rund 13'300 Mitarbeitende in 46 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte das Flow-Solutions-Geschäft von GF einen Umsatz von CHF 3 Mrd. GF ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Unter [www.georgfischer.com/aboservice](https://www.georgfischer.com/aboservice) können Sie sich für unseren Abonnement-Service für Journalisten anmelden. Sie erhalten dann automatisch unsere aktuellen Medienmitteilungen.



**Bilder**

	<p>Jetzt mit OCP Inspired™-Siegel: Die Auszeichnung des PVDF-In-Rack-Verteilers von GF für Direct-to-Chip Liquid Cooling unterstreicht die zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Polymerwerkstoffe als medienführende Komponenten in Kühlmittelinfrastrukturen der nächsten Generation.</p> <p>Quelle: GF</p>
	<p>Der PVDF-In-Rack-Verteiler unterstützt eine gleichmäßige Strömungsverteilung, korrosionsfreien Betrieb, ein geringes Gewicht sowie die flexible Integration in hochdichte KI-Rechenzentrums-umgebungen.</p> <p>Quelle: GF</p>



Die Engineering-Experten von GF entwickeln jeden Verteiler entsprechend den kundenspezifischen Rack-Layouts und Kühlanforderungen, um eine optimierte Strömungsleistung, eine nahtlose Integration und einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Kühlkreislauf hinweg sicherzustellen.

Quelle: GF



**OCP**  
**INSPIRED™**